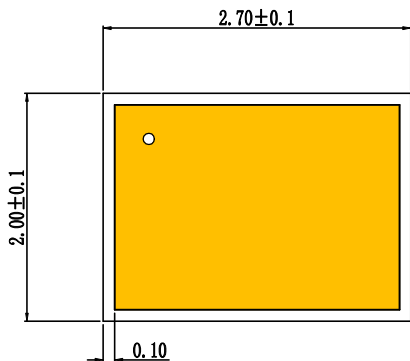
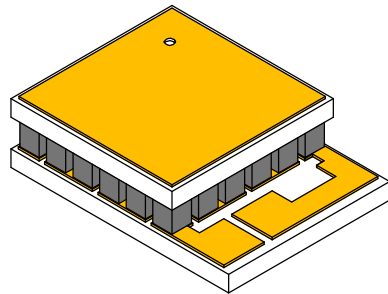
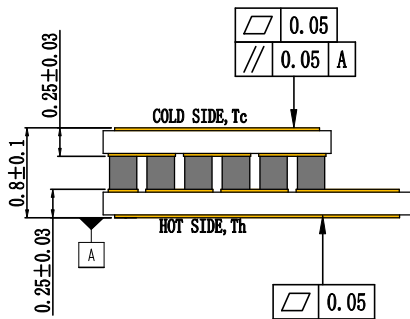
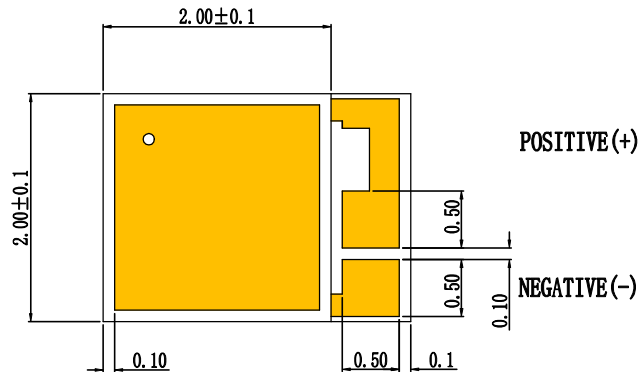




升版记录

版 本	更 改 内 容	修 订 者	日 期
A1	初版发行		21/09/14
A2	1、热面基板定位孔重定义位置；2、性能参数优化，电阻值变更。		22/12/10

Material

①	晶粒对数：18对 PN pellets:18 pairs
②	冷热面陶瓷基板材料：ALN Hot and Cold Side Substrates: Ceramic
③	表面金属化层材料组成：Cu/Ni/Pd/Au；厚度：20um/3~7um/0.075um/0.1~0.15um Gold Flash Finish
④	焊料层材料组成：AuSn；最高允许工艺温度265℃，2min Soldering 265 Celsius

Paramter

Th=27℃				Th=50℃				Ta=27℃
ΔTmax/℃	Qc max/W	Umax/V	Imax/A	ΔTmax/℃	Qc max/W	Umax/V	Imax/A	ACR/Ω
70.3	1.3	2.1	1.0	81.6	1.4	2.3	1.0	1.576±10%

未注公差: ±0.05mm				 HUA HUI		产品名称	热电制冷器件 (TEC)
						产品型号	TEM1-018010B-NM-3B
设计		会签		物料编码	比例	产品图号	TZ-5261-A2
审核		标准化			10:1	客户编码	
工艺		批准		共 1 页	第 1 页		